

公司代码：603068

公司简称：博通集成

博通集成电路(上海)股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据第三届第四次董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 150,424,966 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金 7,521,248.30 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润待以后年度分配。本预案尚须股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博通集成	603068	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李丽莉
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号41幢101（复式）室2F-3F/102（复式）室
电话	021-51086811 分机8899
电子信箱	IR@BEKENCORP.COM

2 报告期公司主要业务简介

1、行业概况

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售。集成电路行业作为是全球信息产业的基础，是带动传统产业迈向数字时代的引擎和基石。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业，业内企业普遍具备较强的技术研发能力、资金实力、客户资源和产业链整合能力。

经过近 20 年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。2022 年中国集成电路产业销售额为 12,006.1 亿元，同比增长 14.8%。其中，设计业销售额 5,156.2 亿元，同比增长 14.1%；制造业销售额为 3,854.8 亿元，同比增长 21.4%；封装测试业销售额 2,995.1 亿元，同比增长 8.4%。根据市场研究机构数据，2023 年中国集成电路行业市场规模将达 13,093 亿元，同比增长 8.8%。

2、行业的周期性、区域性、季节性

行业周期性上，集成电路设计行业是一个靠技术创新推动的科技产业，其周期性主要体现在产品创新周期、上下游产能供需周期和宏观经济波动周期上。从产业链特征来看，由于集成电路产业资本投入大、回收期长，往往需要政府的推动，因此政策和政府行为也是行业周期性不容忽略的变化因素。现阶段集成电路设计行业日益成熟，行业整体波动幅度和周期性趋于减弱。

行业区域性上，集成电路的设计企业主要集中在上海、广州、珠海、北京等城市。在国家明确将集成电路产业上升至国家战略后，地方版集成电路规划相继出台。我国集成电路产业发展格局已基本形成了珠三角、长三角、京津环渤海地区三足鼎立之势。

集成电路设计行业存在一定季节性，主要与下游终端产品的市场需求相关。通常情况下，国庆、“双 11”、春节期间电子产品需求相对旺盛，下游客户需要提前备货准备生产，导致芯片等原材料需求增长。

3、公司所处的行业地位

公司专注于无线通讯集成电路芯片的设计与研发，经过多年的发展和积淀，公司已经成为国内领先的芯片设计公司，也是经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等联合认证的“国家规划布局内重点集成电路设计企业”，同时拥有“集成电路设计认证企业”和“高新技术企业”资质证书。

公司通过在行业内多年的经营，积累了诸多稳定的客户群体并树立了良好的品牌形象，在国内消费电子和工业应用无线 IC 的部分相关细分领域市场占有率处于领先地位。在国家大力推动集成电路产业的历史机遇下，公司将凭借多年积累的竞争优势和业务布局，不断强化公司的竞争壁垒，继续保持较快的销售收入增长速度，进一步提升公司在行业内的市场份额。

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。公司目前产品应用类别主要包括 5.8GHz 产品、Wi-Fi 产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等。上述产品广泛应用在蓝牙音箱、无线键盘鼠标、游戏手柄、无线话筒、车载 ETC 单元等终端。

公司作为国内领先的集成电路芯片设计公司，经过十余年的产品和技术积累，已拥有完整的无线通讯产品平台，支持丰富的无线协议和通讯标准，为包括多个世界知名品牌在内的国内外客户提供低功耗高性能的无线射频收发器和集成微处理器的无线连接系统级（SoC）芯片，并为智能交通和物联网等多种应用场景提供完整的无线通讯解决方案。未来公司将基于已有的技术积累和市场资源，充分发挥公司产品种类齐全、应用方案完善、反应速度快等优势，实现品牌价值的最大化，并布局智能交通、智能家居、智能穿戴等物联网市场，进一步巩固公司在市场和技术上的领先地位。

位。

1、无线数传类芯片

无线数传类芯片采用无线通讯的方法实现数据传送和接收，公司产品主要包括独立的射频收发器，集成微处理器（MCU）的无线微控制器，符合国家标准的高速公路不停车收费（ETC）芯片组，以及支持完整通讯协议和安全协议的低功耗蓝牙（BLE）、传统蓝牙（BT）芯片、Wi-Fi 芯片等。

公司无线数传类产品主要应用于高速公路不停车收费（ETC）、无线键盘和鼠标、遥控手柄和无人机飞控等领域，终端客户覆盖了包括美的、海尔、海信、涂鸦智能、金溢科技、雷柏科技、大疆科技等国内知名企业。

2、无线音频类芯片

无线音频类产品采用无线通信的方法实现音频信号的传送和接收，包括独立的射频收发器，集成音频信号采集、播放、编解码的无线音频系统芯片（SoC），集成经过标准化组织认证的射频和数字基带并集成音频信号采集、播放、编解码的标准协议的音频蓝牙芯片和多款 CMOS 全集成收音机芯片等。

公司无线音频类产品主要应用于无线麦克风、无线多媒体系统、蓝牙音箱、蓝牙耳机和智能音箱等领域，终端客户包括摩托罗拉、LG、夏普、飞利浦和阿里巴巴等。

（二）经营模式

集成电路设计企业按照企业是否自建晶圆生产线或封装测试生产线分为存在两种经营模式：IDM 模式和 Fabless 模式。

公司的主要经营模式为 Fabless 模式，即“没有制造业务、只专注于设计”的一种经营模式。采用该种经营模式的公司只从事产业链中的集成电路设计和销售环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，公司取得测试后芯片成品销售给客户。

公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，以 Fabless 模式为主要经营模式，因此产品设计与研发环节属于公司经营的核心流程，由研发中心具体执行。公司的研发中心下设系统设计部、数字设计部、射频模拟部、版图设计部、软件开发部、应用和方案部、技术支持部等七大部门，分工明确，相互协作。多年以来，公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖产品开发立项、产品设计、样品试产、量产推广等阶段，确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强而有效的管控。

在 Fabless 模式下，公司专注于集成电路的设计，而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。目前公司的主要晶圆制造厂为台湾联电、中芯国际、华虹宏力等，主要封装测试厂为长电科技、杭州朗迅、南通富士通、台湾久元和台湾全智等。

公司销售采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，公司与经销商的关系属买断式销售关系，即公司将商品销售给经销商后，商品的所有权已转移至经销商。通过该销售模式可以使公司更好的专注于产品的设计研发环节，提高产业链各个环节的效率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	1,920,610,716.35	2,019,656,840.36	-4.90	2,332,606,162.08

归属于上市公司股东的净资产	1,706,082,791.41	1,799,855,261.00	-5.21	2,026,440,778.09
营业收入	704,589,752.32	713,221,412.08	-1.21	1,094,992,693.75
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	704,589,752.32	713,221,412.08	-1.21	1,094,992,693.75
归属于上市公司股东的净利润	-94,027,610.86	-238,060,644.74	不适用	58,463,643.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,917,028.01	-236,653,148.16	不适用	44,913,801.58
经营活动产生的现金流量净额	41,049,600.54	-201,766,292.07	不适用	166,812,462.30
加权平均净资产收益率(%)	-5.36	-12.48	不适用	2.88
基本每股收益(元/股)	-0.63	-1.58	不适用	0.39
稀释每股收益(元/股)	-0.63	-1.58	不适用	0.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	159,082,026.94	177,446,175.77	183,499,440.36	184,562,109.25
归属于上市公司股东的净利润	-36,724,143.51	-15,405,440.47	-38,215,831.95	-3,682,194.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,232,074.84	-15,223,692.95	-38,480,028.47	-32,981,231.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,298,638.54	79,682,031.70	-39,862,103.34	9,528,310.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					31,714		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					32,199		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
Beken Corporation	0	30,340,103	20.17	0	无		境外法 人
上海致能工业电子有 限公司	0	14,493,846	9.64	0	无		境内非 国有法 人
上海安析亚管理咨询 合伙企业（有限合伙）	0	4,941,268	3.28	0	无		境内非 国有法 人
上海英涤安管理咨询 合伙企业（有限合伙）	0	4,211,300	2.80	0	无		境内非 国有法 人
上海武岳峰集成电路 股权投资合伙企业（有 限合伙）	0	3,740,896	2.49	0	无		境内非 国有法 人
香港中央结算有限公 司	2,688,901	3,470,203	2.31	0	无		境外法 人
建得投资有限公司	-2,578,700	1,521,278	1.01	0	无		境外法 人
上海帕溪菲管理咨询 合伙企业（有限合伙）	0	1,437,500	0.96	0	无		境内非 国有法 人
普訊玖創業投資股份 有限公司	-442,000	1,187,996	0.79	0	无		境外法 人
中国工商银行股份有 限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指 数型证券投资基金	1,136,000	1,136,000	0.76	0	无		境内非 国有法 人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司股东安析亚、英涤安、帕溪菲为员工持股平台，执行事务合伙人为艾蛮特，艾蛮特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司；Beken Corporation、安析亚、英涤安、帕溪菲为同一控制下企业。2. 上海致能工业电子有限公司与上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情形

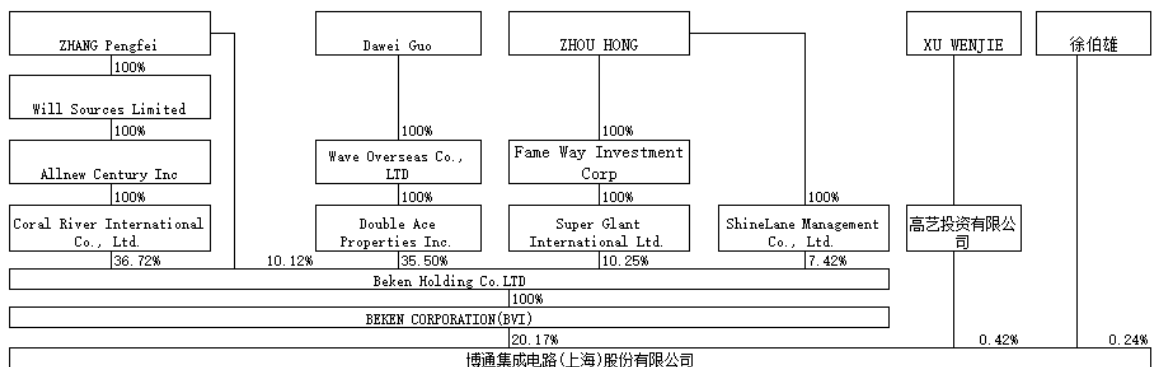
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度公司共实现合并营业收入人民币 70,458.98 万元，同比减少 1.21%；归属于母公司股东的合并净利润人民币-9,402.76 万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用